

1. 解釋名詞：(20%)
 - a. Polymerization shrinkage; b. C-factor; c. Microleakage; d. Hybrid layer.
2. 在填補過程中，若遇到直接覆髓的情形(direct pulp capping)，試舉分別以氫氧化鈣(calcium hydroxide)與另一種覆髓材料覆髓後，牙髓癒合的修復過程，加以說明。(20%)
3. 試由組成、塗抹層(smear layer)處理、牙本質黏著層等各方面解釋全酸蝕(total etching)牙本質黏著劑(dentine bonding agent)與自酸蝕牙本質黏著(self-etching bonding)技術的差異。(20%)
4. 試就 磷酸鋅黏著劑(zinc phosphate cement)、樹脂黏著劑(resin cement)的組成、黏著補綴物應用範圍、優缺點、注意事項等加以說明。(20%)
5. 比較金合金鑲嵌 (gold inlay)與磁鑲嵌(ceramic inlay)的優缺點，與窩洞製備外形的不同處。(20%)